

技術詞彙

本技術詞彙載有本招股章程有關本集團業務的若干詞彙的釋義或解釋。因此，此等詞彙及彼等的涵義未必與業內標準涵義或用法相同。

「自動化光學檢查」或「AOI」	指	檢查電路版瑕疵(如短路、針孔等)的自動工序。電腦將附有電腦輔助設計檔案電路設計影像(cad file layout image)並與所有電路版作比較的工序
「CAD」	指	電腦輔助設計，為工程師用以創造設計之系統，以肉眼視察圖形屏幕或電腦打印輸出或繪圖的影像。在電子行業中，輸出為印製電路設計
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CNC鑽孔」	指	電腦數控鑽孔機，用以在一塊PCB上按數據檔案所指定的特定位置鑽孔
「DVD」	指	數碼影碟
「去毛刺」	指	經過鑽孔後，從PCB的表面可找到多餘的銼屑及碎片。去毛刺指去除此等瑕疵的工序
「焊膜」	指	於電路影像曝光前，以熱力滾壓到覆銅板的感光膜
「EMS」	指	「電子製造服務」的縮寫
「entek」	指	此類塗層為一種名為entek的有機可焊接防腐保護膜，防止銅面的進一步氧化，並保持良好的可焊接性
「蝕刻」	指	透過化學工序去除無用銅質的工序
「助焊劑」	指	焊接的保護劑
「HDI」	指	「高密度連接電路」的縮寫
「熱風噴錫」	指	將一層焊料(錫-鉛)或不含鉛焊料(錫-銅)鋪於PCB的銅表面上的工序，其後並利用高壓熱風除去過剩焊料

技術詞彙

「集成電路」	指	集成電路，包括在硅片上鑲嵌大量電子元件的小型半導體裝置
「ISO」	指	國際標準組織 (International Organisation for Standardisation) 公佈的一系列質量管理及質量保證標準的縮寫，該組織是一個總部設於瑞士日內瓦的非政府組織，以評估商業機構的質量制度
「ISO 9001:2000」	指	ISO 9000系列之組成部分，涉及的範圍包括管理責任；品質制度；合約審查；文件及數據控制；採購；監控客戶提供的產品；產品識別及追查；工序控制；檢查及測試；計量及設備測試；控制不合格產品；修正及預防措施；處理；儲存；包裝、保存及運送；品質控制紀錄；內部品質審核；培訓；維修及統計技術
「阻抗控制」	指	阻抗控制指設計及製造高頻電頻版的雙重工序。隨著電路的頻率增加至某一點 (數百兆赫)，電路將作為傳輸線，並須進行阻抗配對。這類電路中，電路的特點是其幾何功能，而且阻抗控制須參照若干參數 (如物料介電常數、電路版的厚度、傳輸線闊度及空間闊度等) 計算。製造這類電路須嚴緊地控制上述參數，以將阻抗控制固定至若干百分比的歐姆
「覆銅板」	指	覆銅板是PCB的基本原材料。覆銅板由一塊完全固化樹脂的薄版組成，而這些薄版則以銅箔覆蓋。樹脂作為PCB的電絕緣體，而銅箔則製造PCB所需的電路
「LCD」	指	液晶體顯示
「OEM」	指	「原設備製造商」的縮寫
「開路／短路測試」	指	通過將測試引線連接至測試系統的測試裝置，對裸版進行的電器測試，並比較從測試電路版及標準版讀取的連接／絕緣數據

技術詞彙

「焊盆」	指	焊盆指元件導線的銅觸點，一般通用的形狀為圓形、正方形及長方形等
「PC」	指	「個人電腦」的縮寫
「PCB」	指	「印刷電路版或印刷線路版」的縮寫
「半固化黏合材料」	指	半固化黏合材料是PCB的基本原材料。它是一層半固化樹脂，用作黏合內層，形成一塊多層PCB
「研發」	指	「研究及開發」的縮寫
「銑板」	指	以數控銑床加工製作PCB外型尺寸
「絲印」	指	借助絲網印刷加上塗層的工序
「阻焊式防焊油墨」	指	印刷於PCB上的非導電化學油墨，以保護電路免受氧化及短路
「除去抗蝕刻層」	指	透過化學作用去除硬化的感光抗蝕劑塗層工序，以顯露底下的銅質
「通孔」	指	一般用作元件引線及管道的電路版的一種鑽孔。該孔的孔牆壁鍍上銅質，因而令層與層之間的電路能連接起來
「VCD」	指	影碟
「VCR」	指	錄影機